

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-05-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（2023 年度） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与人员	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 05 月 08 日 15:00-17:00
网址	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接 待人员姓名	董事长、总经理：邱醒亚先生 独立董事：王明强先生 副总经理、财务负责人：王凯先生 副总经理、董事会秘书：蒋威先生 保荐代表人：曾文强先生
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p style="text-align: center;">本次业绩说明会采取文字问答方式与投资者进行交流，2023 年度业绩说明会主要内容整理如下：</p> <p>1、公司近期是否会定增，将国家大基金在子公司的股权置换到上市公司？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！根据2023年9月公司接到的大基金管理方的函告，其有意选择由公司现金回购广州兴科半导体有限公司股权的方式实现退出，具体退出方案及相关安排请留意公司后续公告。感谢您的关注。</p> <p>2、请问，收购的北京兴斐一季度盈利情况如何，相对去年增长多少？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！北京兴斐2024年一季度经营表现较好，</p>

实现稳定盈利，具体情况请留意公司定期报告。感谢您的关注。

3、请问目前公司FCBGA能够量产的最高层是多少？产能是多少？

回复：尊敬的投资者，您好！按照现有设备和团队能力，公司已具备20层及以下FCBGA封装基板产品的量产能力，20层以上产品处于测试阶段。目前珠海工厂和广州工厂一期的产能均为约200万颗/月。感谢您的关注。

4、公司之前介绍FCBGA封装基板高层板良率已达到85%，低层板良率已达到90%。请问高层板是指14层以上20层以下还是？

回复：尊敬的投资者，您好！FCBGA封装基板高层板良率达到85%指的是14层以上20层以下的产品。感谢您的关注。

5、请问珠海csp工厂一季度的产能利用率是多少？环比23年四季度提升多少？

回复：尊敬的投资者，您好！受春节假期影响，珠海CSP工厂2024年一季度产能利用率较2023年四季度基本持平。感谢您的关注。

6、您好，发现公司的ESG表现被华证评为BB，请问公司是如何看待自身的ESG尤其是治理方面的表现呢？贵公司打算采取哪些具体措施来增强内部治理结构、提升风险管理水平，以提高公司在治理方面的ESG评级？

回复：尊敬的投资者，您好！ESG治理是在公司主营业务之外的软实力体现，也是展示公司文化、社会责任、规范治理等方面的窗口，对于公司而言还有需要优化提升的空间。未来公司将通过规范三会运作、提升信息披露和投资者关系管理水平、加强绿色运营和可持续发展能力、做好员工赋能和人文关怀、强化产业链合作与共赢、切实承担社会责任等方式提升公司ESG治理能力。感谢您的关注。

7、公司在2023年的净利润出现了下降的主要原因是什么？未来有哪些措施来改善这一状况？

回复：尊敬的投资者，您好！2023年公司净利润下降一方面是因为行业需求不振、供过于求以及由此导致的产能利用率下降、价格竞争激烈，另一方面是因为FCBGA封装基板项目的费用投入和珠海兴科CSP封装基板产能爬坡阶段的亏损，其中FCBGA封装基板业务（包括珠海和广州工厂）全年费用投入39,594.00万元，珠海兴科项目全年亏损6,625.30万元。未来公司将围绕既定的战略方向，坚守先进电子电路方案主业，全面聚焦数字化转型和坚持高端封装基板业务的战略性投资，并在此基础上坚持研发

投入和工艺能力创新，加强市场拓展能力，实现主营业务的增长。感谢您的关注。

8、能否介绍一下公司在可持续发展方面的具体实践和未来规划？

回复：尊敬的投资者，您好！关于公司在可持续发展方面的具体实践请参考公司披露的《2023 年度环境、社会和公司治理报告》。公司未来将通过规范三会运作、提升信息披露和投资者关系管理水平、加强绿色运营和可持续发展能力、做好员工赋能和人文关怀、强化产业链合作与共赢、切实承担社会责任等方式提升公司 ESG 治理能力。感谢您的关注。

9、公司在 2023 年是否有进行任何重大的并购活动？这些活动对公司的长期增长有何影响？

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年 7 月，公司完成北京兴斐电子有限公司的收购，实现高阶 HDI 板和 SLP（类载板）产品能力的突破，业务范围拓展至高端手机、光模块等领域。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实现减成法（Tenting）、改良半加成法（mSAP）、半加成法（SAP）等全技术领域的全覆盖，产品类别涵盖传统多层 PCB、软硬结合板、高密度互连 HDI 板、类载板（SLP）、ATE 半导体测试板、封装基板（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）等全类别先进电子电路产品，具备从 50 微米至 8 微米高端精细路线产品的稳定量产能力，为客户提供了从设计到测试交付的高价值整体解决方案。感谢您的关注。

10、公司如何应对当前全球供应链的不确定性，以及这对公司的生产和销售有何影响？

回复：尊敬的投资者，您好！目前 PCB 行业面临的挑战包括整体需求偏弱，供应链外迁导致的需求外溢，以及大宗商品价格上涨带来的成本上升压力。公司已建立全球化的销售网络，在广州、珠海、宜兴、北京和英国等地建立生产基地，产品类别涵盖传统多层 PCB、软硬结合板、高密度互连 HDI 板、类载板（SLP）、ATE 半导体测试板、封装基板（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）等全类别先进电子电路产品。一方面通过加大研发投入和工艺能力创新，提升公司在新产品、新技术、新材料方面的核心竞争力；另一方面通过优化订单结构、加强与供应商合作深度保障供应链安全稳定，降低原材料成本上涨带来的压力。感谢您的关注。

11、公司在报告期内的研发投入有显著增长，这是否意味着公司将在未来推出更多创新产品？能否透露一些即将到来的产品或技术？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将持续加大研发投入和工艺能力创新，增强公司核心竞争力。公司成功开展了高密度垂直探针卡技术开发与产业化、FCBGA 封装基板技术开发、光模块产品等新项目的研发，提升公司在相关领域的技术领先优势并形成新产品规模化转化能力。在玻璃基板、磁性基板、多层基板内埋工艺等新技术开发层面有序推进，在核心材料、生产工艺层面均有突破。感谢您的关注。

12、董事长好，请问一季度广州、珠海兴森半导体公司盈亏是否达到平衡？如果还是亏损，请问亏损额度大概各是多少？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司 FCBGA 封装基板业务将于 2024 年第二季度进入量产阶段，目前仍处于亏损阶段。具体经营数据请参考公司定期报告。感谢您的关注。

13、年报中提到了公司在数字化转型方面的努力，能否具体说明这一转型对公司未来竞争力的提升将产生哪些积极影响？

回复：尊敬的投资者，您好！数字化将助力公司实现从“制造”到“智造”的转型，通过提升工厂的生产周期、准交率和良率来实现制造能力提升和经营效率优化。感谢您的关注。

14、请问公司的 FCBGA 基板是否已经到了量产阶段？

回复：尊敬的投资者，您好！公司珠海 FCBGA 封装基板项目预期于 2024 年第二季度开始小批量量产，广州 FCBGA 封装基板项目处于工厂审核阶段，预期于 2024 年第三季度完成产品认证之后进入量产阶段。感谢您的关注。

15、请问公司的珠海 FCBGA 产线是否已经开启量产？

回复：尊敬的投资者，您好！公司珠海 FCBGA 封装基板项目预期于 2024 年第二季度开始小批量量产。感谢您的关注。

16、请问公司的 FCBGA 基板是否已经开始量产？

回复：尊敬的投资者，您好！公司珠海 FCBGA 封装基板项目预期于 2024 年第二季度开始小批量量产，广州 FCBGA 封装基板项目处于工厂审核阶段，预期于 2024 年第三季度完成产品认证之后进入量产阶段。感谢您的关注。

17、公司的 FCBGA 产线和产品早已通过大客户认证，原计划去年十二月份开启量产，后推迟到三月份量产，但是事实上至今没有开启量产，请问具体的原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 FCBGA 封装基板项目珠海工厂和广州工厂一期产能均已建成，并已通过部分国内标杆客户的工厂审核，产品

	<p>认证和海外客户拓展按计划推进,预期将于 2024 年第二季度逐步进入量产阶段。感谢您的关注。</p> <p>18、华为认证情况如何? ABF 载板什么时候能放量?</p> <p>回复: 尊敬的投资者,您好!公司与具体客户的合作因涉及保密协议不便披露。公司 FCBGA 封装基板项目珠海工厂和广州工厂一期产能均已建成,并已通过部分国内标杆客户的工厂审核,产品认证和海外客户拓展按计划推进,预期将于 2024 年第二季度逐步进入量产阶段。感谢您的关注。</p> <p>19、请问公司的测试板业务目前的产能和稼动率情况如何?</p> <p>回复: 尊敬的投资者,您好!公司 ATE 测试板业务产能为 2,000 平米/月,目前产能利用率逐步提升,盈利能力保持稳定。感谢您的关注。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 05 月 08 日